

## 中电科芯片技术股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研      <input type="checkbox"/> 分析师会议  <input type="checkbox"/> 媒体采访            <input type="checkbox"/> 业绩说明会  <input type="checkbox"/> 新闻发布会          <input type="checkbox"/> 路演活动  <input type="checkbox"/> 现场参观              <input type="checkbox"/> 其他_____                 </p>
<p>参与单位 名称</p>	<p>广发基金、国投证券、东海基金、长兴星际、正向投资、普行资产、盈和智投资、盛笃投资、格栅汇投资、媛博投资、华杉投资</p>
<p>时 间</p>	<p>2024年11月7日 10:00-11:00</p>
<p>地 点</p>	<p>现场会议</p>
<p>公司接待 人员姓名</p>	<p>董事会秘书兼财务总监 陈国斌</p>
<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p>                     一、公司情况介绍                      董事会秘书兼财务总监陈国斌先生向与会投资者介绍公司概况、历史沿革、股东背景、业务布局及战略发展方向等内容。                       二、互动交流主要内容                      1、请简要介绍公司 2024 年第三季度业绩情况？                      答：消费电子市场竞争日益激烈，行业内频繁出现价格内卷现象。为了巩固市场份额，公司针对特定领域产品实施降价策略（包括短距离通信、电机驱动及智能电控等），导致公司营业收入缩减。此外，公司部分下游产业，尤其是消费电子领域客户，正面临较大的经营压力，导致公司部分应收账款回收周期延长，信用减值损失相比去年同期有所增加。加之，从 2024 年初至第三季度末公司毛利率下降，以上因素共同导致净利润呈现下滑趋势。                 </p>

为应对当前严峻的经营压力，公司一方面致力于加速内部产业的协同合作与成本效益优化，削减非必要支出；另一方面，不仅在卫星通信、低空经济、工业控制等战略新兴领域积极拓展布局，还将全力推进核心关键技术的研发突破，并加快产品迭代升级和新产品开发的步伐，为后续公司在相关领域可持续发展奠定基础。

**2、请介绍公司卫星通信领域的业务进展情况和未来展望？**

答：卫星通信是公司未来发展的核心战略领域之一，公司专注于开发北斗短报文、窄带语音通信及宽带卫星互联网通信等不同应用场景产品。目前，北斗短报文 SoC 芯片已成功推广至国内五大主流手机厂商，并被应用于近期发布的多款中高端智能手机及智能手表中，为公司经营效益与盈利结构的优化注入了新动力。鉴于国家对北斗系统产业化应用的积极支持与推动，北斗短报文芯片在手机、车载及其他众多行业领域内具有较为广阔的市场空间。公司将持续加大研发投入，深化与客户的战略合作，以期不断推出系列化产品并顺利投放市场。

**3、请问公司在机器人、无人机等智能制造领域是否布局？**

答：公司子公司芯亿达作为电机驱动芯片设计企业，已积累了丰富的集成电路布图和相关研发成果，目前产品应用主要集中在玩具无人机领域。随着机器人、无人机等产品步入成熟期，在农业、物流、应急领域等行业发挥关键作用，子公司芯亿达将推进产品从中低端向中高端转型升级，驱动和电子开关系列产品向低空经济、工业控制以及智能家居等智能制造领域拓展，以提高公司综合竞争力。

**4、请问公司未来在新质生产力领域的布局与规划？是否考虑通过并购重组完善产业布局？**

答：公司将保持成熟核心业务的市场份额和稳定经营，加快公

	<p>司业务向新质生产力方向转型，在卫星通信（手机终端）、低空经济、新能源汽车、工业控制等领域持续实施布局调整，推进新产品的市场推广，努力提升盈利水平和市场竞争力。此外，公司持续跟踪研究资本市场政策，寻求机会优化产业布局，推动公司持续、稳定、高质量发展。如涉及未来资本运作事项，公司将严格按照相关法律、法规的要求，及时履行信息披露义务，请以公司信息披露为准。</p> <p style="text-align: center;"><b>5、请问公司最新的研发方向与进展？</b></p> <p>答：公司明确以北斗短报文 SoC 芯片、宽带/窄带卫星通信、温补晶体振荡器、动力系统电调、高/低边电子开关、高耐压隔离驱动等产品、技术为重点研发方向。在 2024 年前三季度，公司成功开发适用于通信、电子测量等领域的宽温、高精度温补晶体振荡器专用芯片；突破高可靠数模混合设计、高精度补偿算法等关键技术；大电流低边电子开关批量应用于某一线车企多款车型；大电流高边电子开关、多通道半桥驱动器成功进入样品送样阶段。公司研发是发展的基石，通过增强研发强度，持续探寻新技术、新产品与新服务模式，从而在市场竞争中获得优势，强化企业的核心竞争优势。</p>
附件清单	无。
日期	2024 年 11 月 7 日